

シーディアのFA事業では、電気と機械の両部門からの一貫生産体制に加え10社以上の協力会社とのネットワークが特徴。また経験値の高い作業員たちが、各自の工程を責任持って管理することで製品を高品質に保持いたします。このしくみとマンパワーが融合することで短納期でありながら高品質な製品をご提供することが実現します。これがあらゆるご要望に対応できる「CIS」のしくみとなります。

1

技術・設計

多彩なノウハウを持った技術集団が、お客様のご要望に100%お応えいたします。

ハード設計

回路・ハーネス・板金・中板配置図を素早く正確に書き上げます。

ソフト設計

お客様のご要望に合わせた仕様でソフト設計を行います。シーケンス設計は、三菱・オムロン・富士・キーエンス等、多くのメーカーに対応できます。



2

資材調達

少しでも安く良い部品が提供できるよう、数多くの発注先から一番コストメリットが出せる業者への発注をいたします。

部品購入

部品図等のデータを基に部品の調達を行います。各部品により発注先を変動させ、よりメリットが高い購買先への発注を行います。

納期管理・受入検査

部品の納期が確実に守られるか、いつ部材が入ったかなどを管理するシステムを導入しており、納期管理は万全です。部材の受入後は、各物件への仕訳を行いますので、スムーズに製造への引き渡しが可能となります。



3

製缶・塗装

板金図面を元に筐体を製作します。ステンレス・アルミ材の製缶等も幅広く行っております。

加工データ作成

筐体の外形図・配置図を基に、板金加工用のデータを作成いたします。

切断工程

NCタレットパンチプレス・レーザー加工機により、材料（SPC）の外形切断を行います。

曲げ工程

切断した材料をプレスブレーキにより曲げ加工を行います。

製缶・塗装工程

部材を溶接して製缶し、塗装します。

外観・膜厚検査

加工品はすべて、製造に引渡す前に、外観・膜厚の検査を行います。



4

組立・配線

お客さまの配線仕様書・回路図面を基に、板金中板に機器を配置取付をし、結線して制御盤を完成させるプロセスです。

配線用マークチューブ・デバイス作成

図面より配線マークチューブ・機器名称シール・TB記録シールを入力し、ホットマーカより出力する。

ケガキ・器具付け作業

中板に部品のレイアウトをし、機器取付・デバイスシールの貼り付けを行います。

配線作業

製作図面を確認し主回路・制御回路の配線を行います。

仕上げ

配線をした中板を、筐体の中に入れ、未配線部分の配線を行います。

終了確認作業

自主検査シートに従い、自主チェック及び清掃を行い、検査工程へ引き渡します。



5

検査・出荷

完成した制御盤が仕様通りに出来上がっているか検査し、出荷準備、出荷をするプロセスです。

外観・構造・塗装の検査

外形寸法・銘板・表示器等が正しく配置されているか、塗装の仕上がり、膜厚に不備がないかを検査いたします。

耐電圧試験

定められた高電圧を電線と機器にかけて、耐久性を試験いたします。

配線検査

回路図面通りに配線されているか、実際に通電して正しく動作するかを検査します。

動作試験

仕様書やフローチャート通りに動作するか、模擬的に操作し、動作試験（シミュレーション）をいたします。

梱包

制御盤の清掃、付属品の確認後、制御盤を梱包いたします。

出荷

完成した制御盤をトラックに積み込み、出荷、納品。



6

現地工事 改造・調整

経験値の高い技術者が現地で調整・改造を行うことで、不測の事態にフレキシブルにその場に対応。

現地工事

社内調整後に、エンドユーザー様での装置の設置・メカ配線工事を行います。現場が、遠方だとしてもご安心ください。遠方にも協力企業が多くおりますので、海外であっても、どこでも工事対応可能です。

現地改造

改造による部品の追加からシーケンサーの入替作業まで幅広いの改造工事に実績がございます。

現地調整

エンドユーザー様での最終調整・検査立会を技術部のメンバーが行います。